

# 强一半导体(苏州)股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2026 -001

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	线上参与公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的全体投资者
<b>时间</b>	2026年05月11日 15：00-16：00
<b>地点</b>	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长 周明先生 总经理、董事 刘明星先生 董事会秘书 张子涵女士 财务总监 仇春琦女士 独立董事 叶小杰先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>1.（1）公司的探针卡是否可用于光芯片测试？（2）公司2.5D MEMS探针卡今年的产能规划是多少？3D、高频技术与FormFactor比代差是否在不断缩小？（3）钨矿价格大幅度上涨，对公司成本有没有明显的影响？</b></p> <p>答：Q1：公司核心产品覆盖2D MEMS探针卡、2.5D MEMS探针卡、薄膜探针卡、垂直探针卡、悬臂探针卡等全系列探针卡。薄膜探针卡主要应用领域为射频芯片和光电子芯片，公司的薄膜探针卡目前主要应用于高频电芯片，已成功完成110GHz高频探针卡技术开发并送样，处于客户验证阶段。</p> <p>Q2：公司正加速实现高端探针卡的国产化突围，凭借本土化的</p>

	<p>极速响应和不断缩小的技术代差,努力为下游客户提供一条安全、可靠且高性价比的供应链备选方案。2.5D MEMS探针卡方面,2025年公司2.5D MEMS探针卡生产量为27张,同比增长440%,公司依据客户需求等进行产品的设计、生产,主要采取以销定产的经营模式。公司2.5D MEMS探针卡已完成多片面向Flash、DRAM等存储芯片测试用探针卡的小批量出货,并在客户端验证成功,在装针数量、并测数量、针痕质量、小间距测试能力等方面持续开发创新。公司规划尽快实现国产存储龙头的产品验证以及交付。2D MEMS探针卡方面,目前公司最先进的2D MEMS探针卡可以应用于境内最先进制程芯片的晶圆测试。在装针数量、小间距测试能力、针痕质量、耐电流能力等方面实现显著提升,并积极探索和验证混针技术及Cu Pad测试技术。目前2D MEMS探针卡产能已提升至月出货300万针。薄膜探针卡方面,目前量产的测试频率达到67GHz,110GHz处于客户验证阶段,力争实现量产突破。薄膜探针卡完成4site并测针卡量产导入及低插损探针卡原型产品开发,在并测数和插损性能方面比肩国际TOP厂商,公司将努力实现薄膜探针卡220GHz的技术攻关。</p> <p>Q3: 公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力,是市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售MEMS探针卡的厂商。公司核心产品覆盖2D MEMS探针卡、2.5D MEMS探针卡、薄膜探针卡、垂直探针卡、悬臂探针卡等全系列探针卡。悬臂探针卡属于传统的非MEMS探针卡,2024年公司悬臂探针卡的收入占比为14.50%,2025年公司悬臂探针卡的收入占比保持稳定。中国是钨资源大国,当前钨价处于连续上涨后的震荡调整阶段,公司没有直接采购钨及钨合金,公司悬臂探针卡装配外购的探针,主要由钨合金或钼合金探针、PCB、机械结构部件等构成。与此同时,公司积极开展自研,深耕PI薄膜、陶瓷基板等核心零部件、探针原材料电镀液及陶瓷基板原材料生瓷银浆的自主研制,努力实现探针卡更高层次的自主可控。公司在研项目中包含开发一款低成本高性能的合金电镀液,目前项目已结项,技术处于业内先进水平。</p> <p><b>2.AI ASIC高速发展,我们公司探针卡除了大客户之外的其他AI ASIC客户上有没有进展?</b></p> <p>答: 当前AI ASIC赛道高速发展,公司除已合作的头部AI算力芯片客户外,在多家AI ASIC领域的优质客户拓展上均取得积极进展,相关客户的验证、送样及小批量订单均在稳步推进中。公司依托成熟的技术平台与快速响应能力,正持续扩大在AI ASIC领域的客户覆盖</p>
--	---

	<p>面与渗透率，相关业务进展请以公司后续披露信息为准。</p> <p><b>3.公司3月份公布了1-2月营收，请问公司这种月份营收公告是未来常态还是不定时公布？需要公布依据和节奏是什么？</b></p> <p>答：公司于2026年3月5日发布的2026年1-2月经营数据公告属于自愿性信息披露，需要遵循自愿性信息披露的相关规定。公司将严格按照监管部门的相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务。</p> <p><b>4.公司上市之后，产能提升，怎么抓住AI ASIC高速发展的机会？</b></p> <p>答：公司上市后依托募集资金加快产能建设与技术升级，将从三方面紧抓AI ASIC高速发展机遇：一是持续深耕头部AI芯片客户，深化产品验证与批量交付，巩固核心合作优势；二是全面拓展AI ASIC领域中小客户与新兴算力厂商，加快送样、测试与导入节奏，扩大客户覆盖；三是围绕AI芯片对高密度、大电流、高频测试的需求，提前布局产能规划与产线升级，确保产能规模、产品性能与快速交付能力精准匹配市场增长需求，持续提升公司在AI测试赛道的市场份额。</p> <p><b>5.强一最近两年有没有新的产能布局？主要是哪方面的产品？</b></p> <p>答：近两年公司围绕战略发展与市场需求持续推进产能布局，重点聚焦MEMS探针卡核心产品，加快2D MEMS与2.5D MEMS探针卡产能建设，以适配AI算力芯片、存储芯片等高速增长测试需求。目前公司成熟量产产线主要位于苏州；新增产能重点布局合肥与南通基地，其中南通募投项目规划打造全自动化产线，通过自动化、数字化升级持续提升生产效率与交付能力。公司现有产能可支撑当前业务增长需求，本次募投项目扩产将重点承接未来新增市场需求。公司将持续深耕高端探针卡赛道，巩固2D MEMS探针卡的市场优势，同步推进2.5D MEMS、薄膜探针卡的技术迭代与规模化量产，不断完善产品矩阵，全面满足先进存储与高端逻辑芯片的测试需求，持续提升核心竞争力与市场份额。</p> <p><b>6.目前中日关系持续紧张。而强一股份依赖日本的核心材料（MLO基板、探针、特种陶瓷、贵金属）存在明确的断供风险。目前是否对生产造成影响？请问是否有备选方案？</b></p> <p>答：公司密切关注基板等原材料市场动态及变化，评估潜在影响，同时持续优化关键材料的本土化采购，增强核心原材料及技术的自主化能力。目前公司生产经营正常。为保证供应链稳定性，控制相关风险，公司逐步在境内寻找产品核心部件及材料供应商。</p> <p><b>7.目前在手订单有多少？是否与英伟达有合作？是否有采用收</b></p>
--	--

	<p><b>并购方式发展探针台业务？</b></p> <p>答：公司经营情况请以后续的定期报告及公告为准；截至目前，公司与英伟达不存在业务合作关系；未来公司将结合自身发展战略、市场机遇综合考量发展路径，如涉及收并购等重大事项，将严格按照监管要求履行信息披露义务，请以公司公告为准。</p> <p><b>8.公司客户中来自存储、逻辑的占比分别是多少？在光通信领域是否有布局？</b></p> <p>答：2024年公司2D MEMS探针卡的收入占比为77.81%，主要应用于非存储领域；薄膜探针卡的收入占比为5.23%，主要应用于非存储领域；2.5D MEMS探针卡的收入占比为1.01%，主要应用于存储领域；悬臂探针卡的收入占比为14.50%，在存储领域及非存储领域均有应用；垂直探针卡的收入占比为1.45%，主要应用于非存储领域。2025年，公司各类探针卡的收入结构整体保持稳定。公司的薄膜探针卡主要应用于射频前端、毫米波、高频高速、光电通信等领域。</p> <p><b>9.业绩介绍？公司探针卡客户认证进度如何？</b></p> <p>答：截至2025年期末，公司总资产44.61亿元，同比增长249.46%；归属于公司股东的所有者权益为40.66亿元，同比增长262.20%。2025年，公司实现营业收入10.12亿元，同比增长57.81%；实现归母净利润3.95亿元，同比增长69.43%，归母扣非净利润3.91亿元，同比增长72.26%。研发投入占营收比重13.06%，比上年增加0.81%。2026年第一季度实现营业收入2.85亿元，同比增长229.39%；归母净利润1.12亿元，同比增长697.60%。目前公司客户覆盖境内外芯片设计、晶圆代工、封装测试等产业链核心企业，累计服务单体客户超400家，包括众多国内头部半导体企业及知名芯片厂商。</p> <p><b>10.请问华为昇腾950的测试是不是用贵公司的探针卡？HBM方面的认证通过了哪几家？是否给长鑫供货？何时量产？谢谢</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，具体经营信息和合作客户请以公司公开披露信息为准。感谢您的关注。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年05月11日</p>